



# 111年半導體封裝製程 專業實務培訓營

## 課程時間 / 地點

111 / 07 / 11 -

111 / 08 / 04 四

明新科技大學明學樓205教室  
半導體封裝測試類產線基地

## 參與對象 / 報名連結

大學教師、在校三年級（含）  
以上學生及具有大學以上學歷  
的社會人士。



Ⓜ 掃描報名

## 課程大綱

## 主辦單位

教育部促進產學連結合作育才平臺-  
國立臺灣科技大學執行辦公室

## 協辦單位

明新科技大學半導體學院類產線計畫辦公室

## 課程目標

鏈結半導體封裝產業，規劃專業與實務兼具  
的培育課程，為學員在職場發展，提供一個  
優質的學習機會。

## 聯絡人

曾鈺燴 助理 03-5593142#3270

## 合作廠商

力成科技股份有限公司

天數	日期	時間	活動內容	講員
第1天	7/11 (一)	09:00-12:00	IC產業發展	呂明峯
		13:00-16:00	晶圓切割機系統概要及參數設置	何信松
第2天	7/12 (二)	09:00-12:00	半導體製程技術	呂明峯
		13:00-16:00	刀具拆裝操作及檢測機制調整	何信松
第3天	7/13 (三)	09:00-12:00	半導體構裝技術的演變	蔡天寶
		13:00-16:00	切割成品的前置作業設定	何信松
第4天	7/14 (四)	09:00-12:00	半導體封裝製程	趙守嚴
		13:00-16:00	晶圓切割機台實機操作	何信松
第5天	7/18 (一)	09:00-12:00	半導體信號重置製程	趙守嚴
		13:00-16:00	黏晶機系統概要及參數設置	何宗穎
第6天	7/19 (二)	09:00-12:00	3D封裝製程	趙守嚴
		13:00-16:00	彈匣及軌道傳送定位及校正	林賢昇
第7天	7/20 (三)	09:00-12:00	先進封裝製程	趙守嚴
		13:00-16:00	黏晶的前置作業設定	林賢昇
第8天	7/21 (四)	09:00-12:00	晶圓級封裝製程	趙守嚴
		13:00-16:00	黏晶機台實機操作	林賢昇
第9天	7/25 (一)	09:00-12:00	面板級封裝製程	趙守嚴
		13:00-16:00	打線機系統概要及參數設置	何宗穎
第10天	7/26 (二)	09:00-12:00	先進封裝的製程發展	王欽宏
		13:00-16:00	瓷嘴更換及調整	黃志賢
第11天	7/27 (三)	09:00-12:00	先進封裝的技術挑戰	張香鈺
		13:00-16:00	打線機彈匣及軌道定位調整	黃志賢
第12天	7/28 (四)	09:00-12:00	半導體的封膠方法及環保製程	趙守嚴
		13:00-16:00	打線機實機操作	黃志賢
第13天	8/1 (一)	09:00-12:00	晶圓切割機操作能力檢測	何信松
		13:00-16:00		
第14天	8/2 (二)	09:00-12:00	固晶機操作能力檢測	林賢昇
		13:00-16:00		
第15天	8/3 (三)	09:00-12:00	打線機操作能力檢測	黃志賢
		13:00-16:00		
第16天	8/4 (四)	09:00-12:00	半導體封裝製程學習評量	蔡天寶
		13:00-16:00	半導體封裝機台實務操作評量	